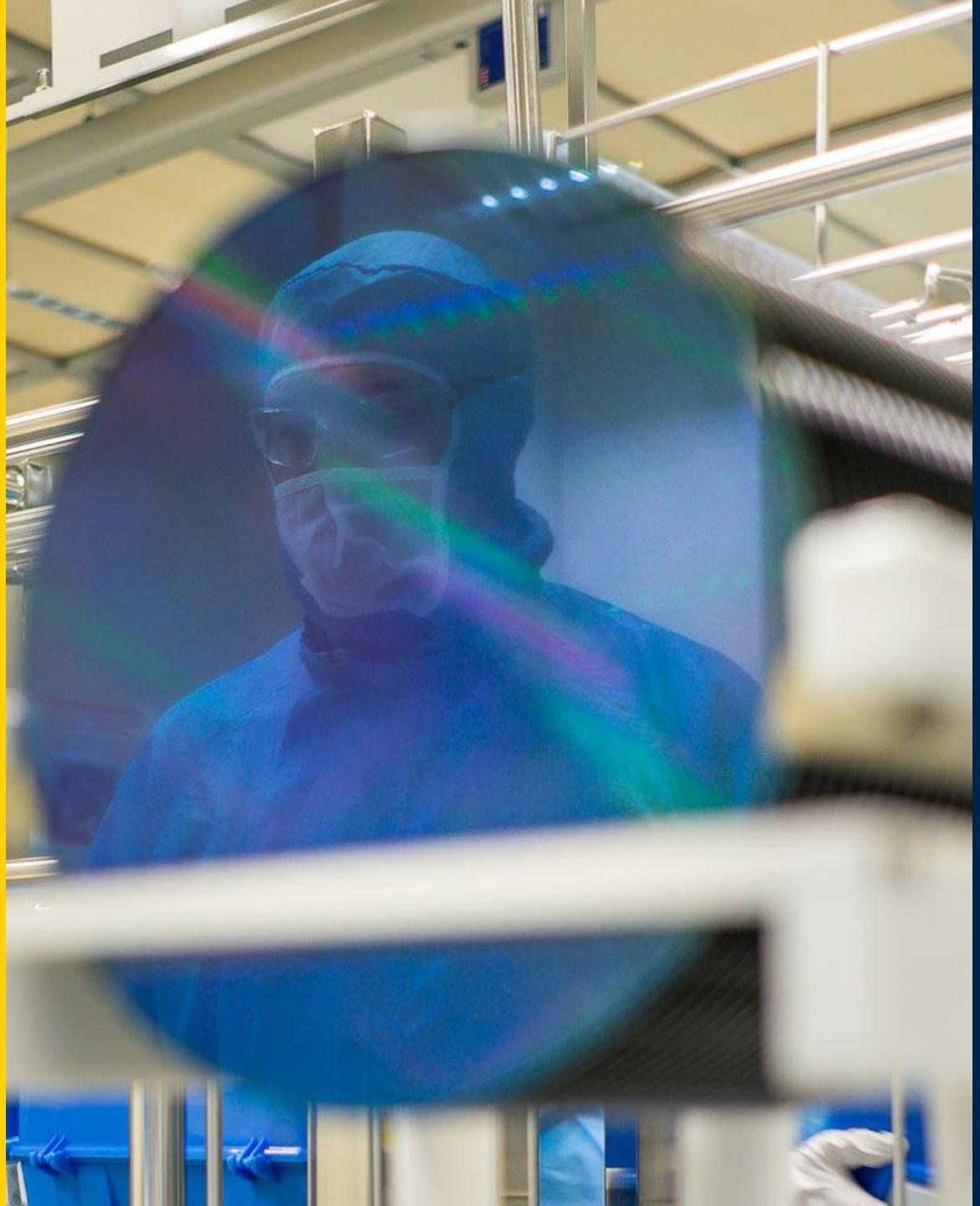




STマイクロエレクトロニクス 会社概要

2025年10月



STマイクロエレクトロニクスについて



グローバルな半導体企業



グループ従業員数: **50,000名以上**
研究開発スタッフ: **9,000名以上**



2024年売上:
133億ドル



世界各国に**80のセールス・オフィス**を持ち、**20万社以上の顧客**をサポート

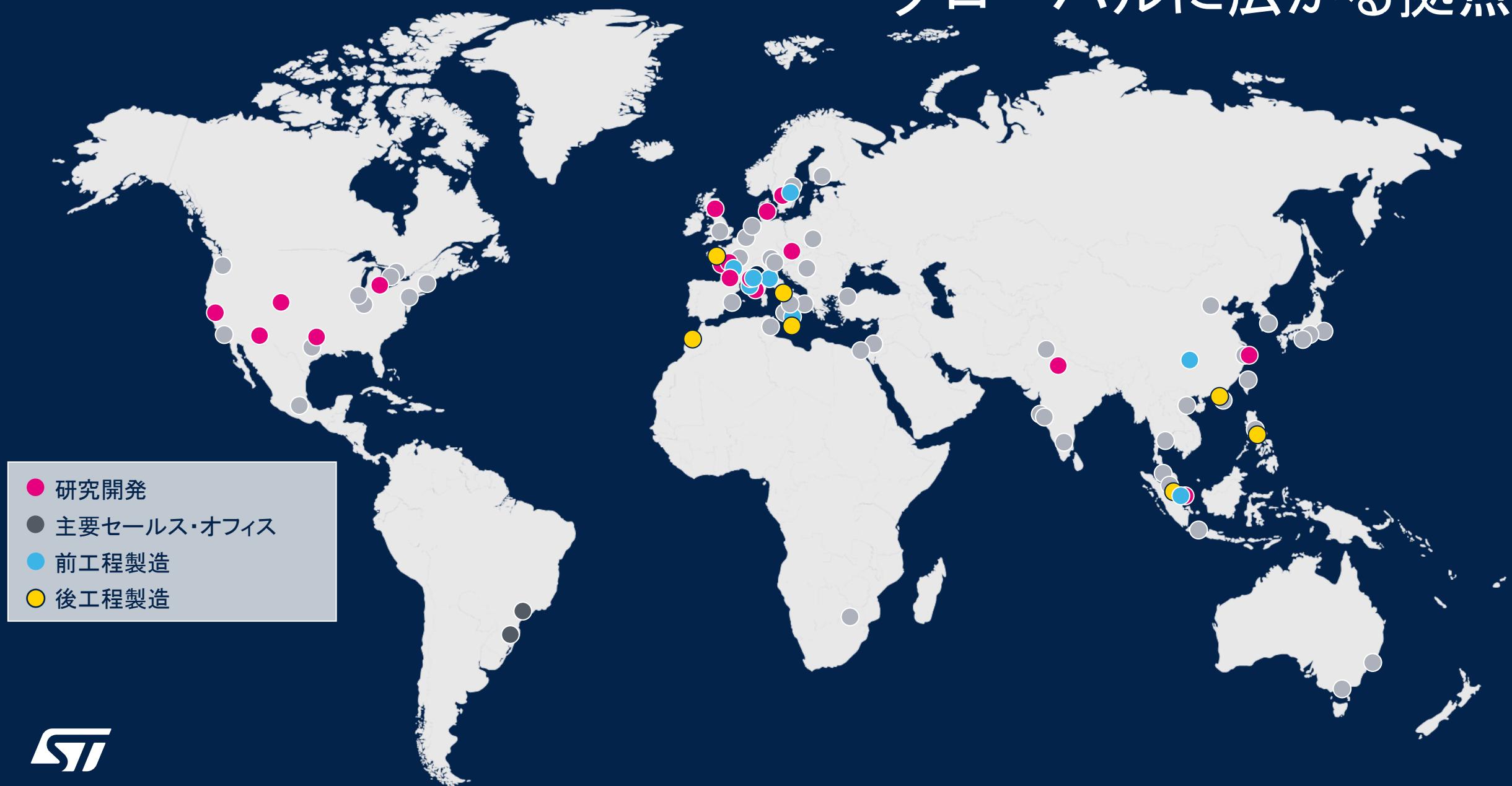


主要工場: **14工場**



国連グローバル・コンパクトの署名企業
レスポンシブル・ビジネス・アライアンスのメンバー企業

グローバルに広がる拠点





Jean-Marc Chery
社長 兼 最高経営責任者



Marco Cassis
アナログ・パワー &
ディスクリート・MEMS
センサグループ



Remi El-Ouazzane
マイクロコントローラ・
デジタルIC・RF製品
グループ



Jerome Roux
セールス
マーケティング



Fabio Gualandris
品質
製造・技術



Lorenzo Grandi
社長 兼 最高財務責任者



Rajita D'Souza
人事・CSR
(企業の社会的責任)



Steven Rose
法務 &
パブリック
アフェアーズ



Mario Aleo
パワー &
ディスクリート****



Ricardo De-Sa-Earp
MDRF副社長****



Michael Anfang
EMEA地区
オートモーティブ*



Christophe Ayela
前工程製造・技術



Franck Freymond
監査*** & リスク管理
レジリエンス



Alberto Della Chiesa
サプライチェーン



**Frédérique
Le Grevès**
ヨーロッパ & フランス
パブリックアフェアーズ



Alexandre Balmefrezol
イメージング



Remi El-Ouazzane
組み込み
プロセッシング****
(兼任)



Henry Cao
中国地区
パワー & エネルギー*



Fabrice Gomez
後工程製造



Giuseppe Notarnicola
財務



Stefano Cantù
戦略的企業プログラム
オフィス



Giuseppe Notarnicola
イタリア
パブリックアフェアーズ



Matteo Lo Presti
アナログ



Alessandro Cremonesi**
システム・リサーチ、
アプリケーション、
イノベーション

****2025年1月1日付け



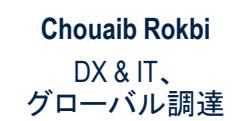
Hiroshi Noguchi
APeC地区
インダストリアル*



Laurent Malier
技術研究開発



Bertrand Stoltz
経理



Chouaib Rokbi
DX & IT、
グローバル調達



Bertrand Stoltz
アジア・パシフィック
パブリックアフェアーズ



Rino Peruzzi
アメリカ地区
PE / CECP*



Nicolas Yackowlew
品質・信頼性



Jérôme Ramel
経営企画、
インテグレイテッド社外
コミュニケーション



Claudia Levo
インテグレイテッド・マーケティン
グ & コミュニケーション

** MDRF社長へ間接的にレポート

APeC = 中国を除くアジア・パシフィック
PE/CECP = パーソナル電子機器 /

通信・コンピュータ周辺機器

* アプリケーション別マーケティング組織

***取締監査役会会長への報告、
ならびに CEOへ間接的にレポート

STのビジョン



ST stands for

life.augmented

STはマイクロエレクトロニクスが
人々の暮らしに役立つ
あらゆるシーンで活躍します

あらゆるステークホルダーに STが提供する価値

投資家への価値



成長指針に基づくりターン

持続可能で利益を生み出す成長

お客様への価値



差別化されたソリューション

セキュアで信頼できる独立したサプライチェーン

その他ステークホルダーへの価値



持続可能性への取り組み

STの価値「倫理観」、「人」、「卓越性」

STのテクノロジーを生み出す「あなた」



STのテクノロジーは
「あなた」とともに生み出されます

私たちの
従業員

私たちの
お客様

私たちの
パートナー

あらゆるシーンで活躍するST製品



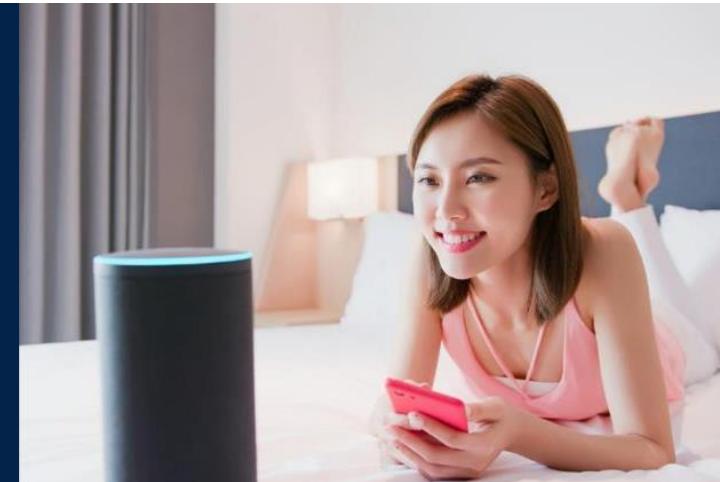
より安全で
環境にやさしく
コネクテッドな運転

よりスマートで安全性が
高く、効率的な工場や
作業現場に向けた
革新的な産業機器

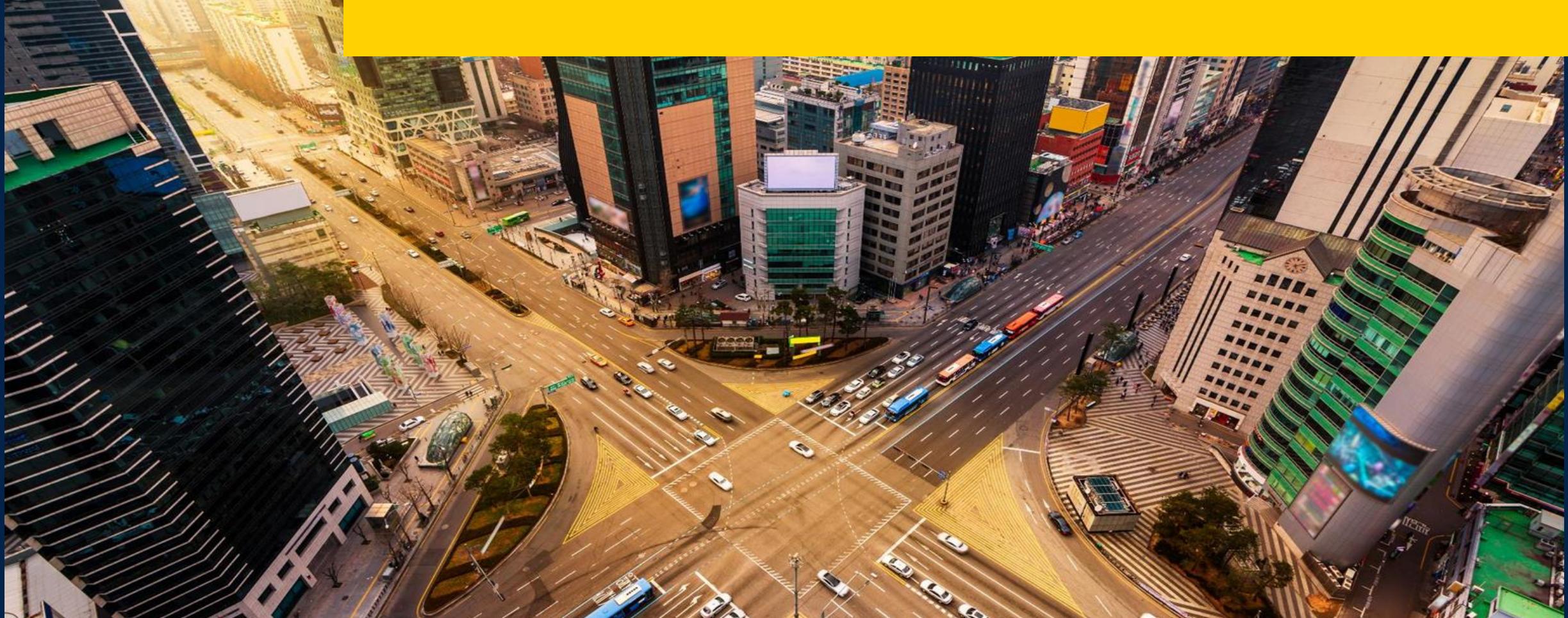


より安全性が高く
資源を効率よく活用でき
より良い生活を可能に
するスマートな
住宅 & 都市

より高性能で
接続性が高く
環境認識が可能な
スマート・デバイス



市場トレンド



長期的なサポートに基づくSTの戦略

スマート・モビリティ



より安全で環境にやさしく
コネクテッドな自動車の
実現に貢献

パワー & エネルギー



電力効率の向上や
再生可能エネルギーの
活用をサポート

クラウド接続型 自律デバイス



エッジAIが実現する
セキュアでコネクテッドな
自律型デバイスの普及をサポート

スマート・モビリティ

より安全で環境にやさしく、コネクテッドな自動車の実現に貢献する
革新的ソリューション



より安全な道路 &
より快適で便利な自動車

交通事故により、多くの犠牲者と
5000億ドルを超えるコストが毎年発生

低価格で魅力的な電気自動車

EV*の売上比率は2030年には約40%に
(2023年:約15%)

より環境にやさしいエンジン(ICE)

2023年～2027年に生産される自動車の
70%以上がICEを搭載

パワー & エネルギー

電力効率の向上や再生可能エネルギーの活用をサポートする
テクノロジー & ソリューション



ますます増加する電力需要

全世界における電力需要の増加は
30%以上(2020年～2030年)



炭素排出量の削減による
地球温暖化対策

1.5°C特別報告書への対応として
45%のCO₂排出量削減目標
(2010年～2030年)

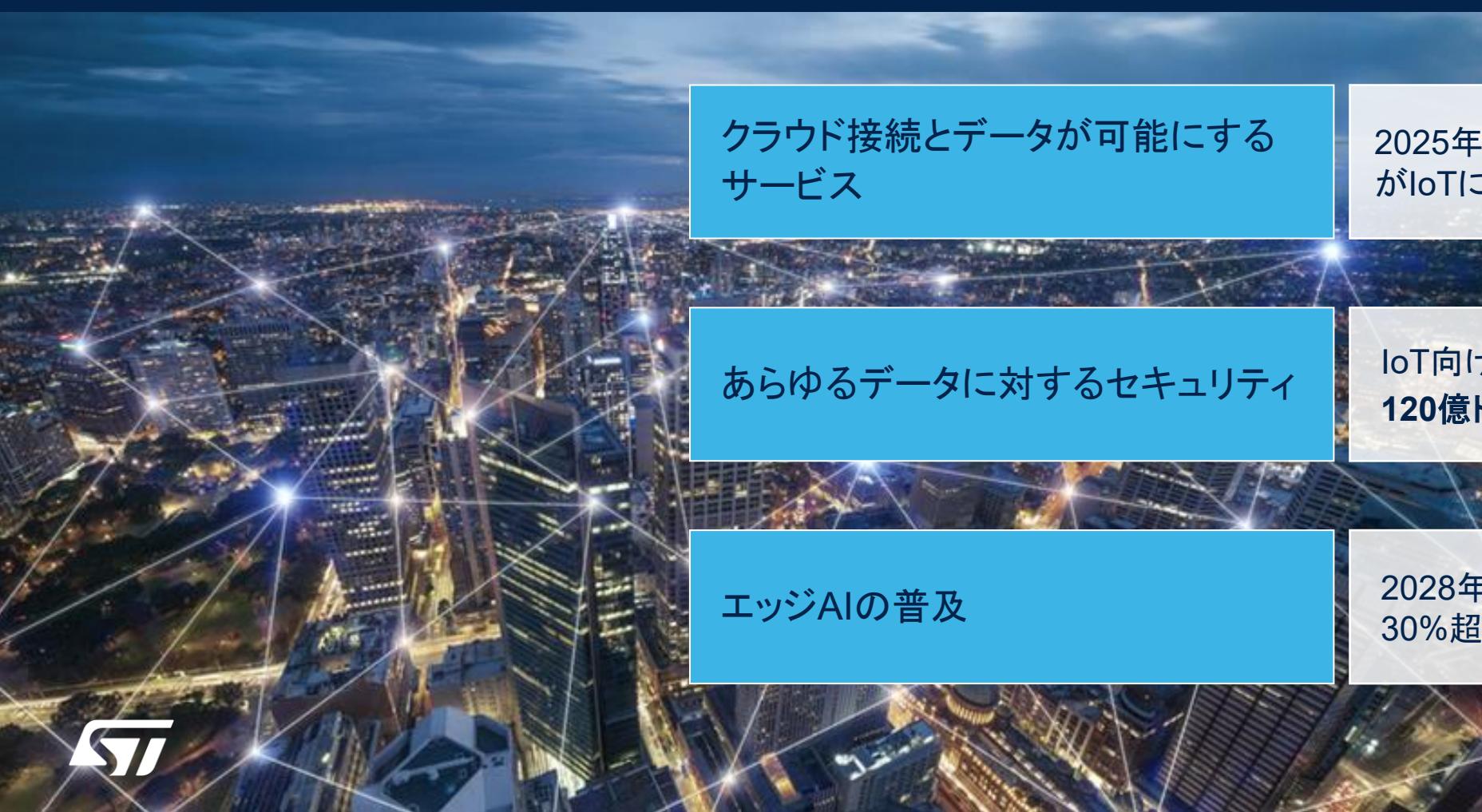


再生可能エネルギーの普及

再生可能資源による電力供給の割合は
約10%(2020年)から約20%(2030年)に

クラウド接続型 自律デバイス

エッジAIが実現するセキュアでコネクテッドな自律デバイスの普及をサポート



クラウド接続とデータが可能にする
サービス

2025年には、年間約200億個のデバイス
がIoTに接続

あらゆるデータに対するセキュリティ

IoT向けセキュリティ市場は2025年に
120億ドル以上の規模に成長

エッジAIの普及

2028にかけて毎年エッジAIデバイスが
30%超増加(2023年: 約10億個)

STの戦略



戦略的な重要エンド・マーケット



オートモーティブ



インダストリアル



パーソナル電子機器



通信機器
コンピュータ周辺機器



重要エンド・マーケットにおける戦略目標

オートモーティブ

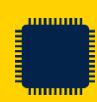


自動車の電動化
をリード



自動車の電子化
をリード

インダストリアル



組込みプロセッシング
をリード



パワー & エネルギー
マネージメントをリード



センサをリード



アナログの成長加速

パーソナル電子機器



差別化された製品や
カスタム・ソリューションで
量産型スマートフォン
向け製品をリード



幅広い製品ポートフォリ
オで量産型アプリケーショ
ンに
対応

通信機器、 コンピュータ周辺機器



差別化された製品や
カスタム・ソリューションで
特定の量産型アプリ
ケーションに対応



幅広い製品ポートフォリオ
で
量産型アプリケーションに
対応

テクノロジー & 製品



差別化されたテクノロジー



MEMS
センサ & アクチュエータ

FD-SOI CMOS
ファンドリを通じたFinFET製造

アナログ & RF CMOS

不揮発性メモリ(eNVM CMOS)

スマート・パワー: BCD
(Bipolar - CMOS - Power DMOS)

**ディスクリート、パワーMOSFET、
IGBT、SiC(炭化ケイ素)、
GaN(窒化ガリウム)**

**Vertical Intelligent Power
(ViPower™)**

光学センシング・ソリューション

パッケージ技術
リードフレーム、ラミネート、センサ・モジュール、ウェハ

顧客のイノベーションに貢献する製品・ソリューション

車載用IC



アナログ
インダストリアル & 電力変換IC



汎用マイコン & MPU、セキュア・マイコン、
ワイヤレスSoC、EEPROM



ディスクリート &
パワー・トランジスタ



MEMS &
光学センシング・ソリューション



STの独自技術に基づく
特定用途向けIC





車載用マイコン



- ・拡張性に優れたシングル / マルチコア・マイコン
- ・コスト制約のある最先端アプリケーションに最適
- ・次世代アーキテクチャ/ X-in-1アプローチ対応
- ・包括的な開発環境

インフォテインメント & テレマティクス



- ・Hi-Fiオーディオ
- ・あらゆる環境下での正確な測位
- ・セキュアなスマートフォン・ミラーリング
- ・さまざまなペリフェラルとの安全な接続

ADASソリューション

- ・イメージ・シグナル・プロセッサ
- ・レーダー・トランシーバ
- ・V2X通信ソリューション
- ・車載用CMOSイメージ・センサ
- ・車載用モーション・センサ

車載用アナログ & パワー



- ・各種ソリューション(バッテリ制御、トラクション、ブレーキ、エアバッグ、ドアゾーン、エンジン、電源制御IC)
- ・ViPower* インテリジェントパワースイッチ、ハイサイド & ローサイド・ドライバ
- ・LEDドライバ
- ・車載用パワー・ディスクリート
- ・包括的なハードウェア開発キット

* STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび/またはその他の地域における関連会社の登録商標および/または未登録商標です。

ディスクリート & パワー・トランジスタ



自動車の電動化、電源制御、モータ制御向け製品 & パッケージ



- 高 / 低電圧シリコン・パワーMOSFET (STripFET*, プレーナ & MDMESH*)
- IGBT / パワー・バイポーラ・トランジスタ
- SiCパワーMOSFET
- GaN-on-Siパワー・トランジスタ / 高周波トランジスタ
- LDMOS & DMOS高周波トランジスタ
- ACEPACK*パワー・モジュール / SLLIMM*インテリジェント・パワー・モジュール

ダイオード、整流ダイオード、サイリスタ(SCR)、ACスイッチ

- SiC(炭化ケイ素) & 高 / 低電圧シリコン・ダイオード
- フアストリカバリ・ダイオード
- パワー・ショットキー・ダイオード & 電界効果整流ダイオード
- サイリスタ(SCR) & トライアック
- ACS* ACスイッチ

過渡電圧サプレッサ(TVS) EMIフィルタ & ESD保護IC

- ESD保護
- EOS & 雷サージ保護
- カレント・リミッタ
- IPAD* EMIフィルタ & ESD保護デバイス
- 集積型受動デバイス(IPD)

* STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび/またはその他の地域における関連会社の登録商標および/または未登録商標です。



アナログ、インダストリアル & 電力変換IC



パワー・マネージメント



- AC/DC & DC/DCコンバータ
- MOSFET, IGBT, SiC, GaN ゲートドライバ
- アナログ & デジタル・コントローラ
- リニア・ボルテージ・レギュレータ
- インテリジェント・パワー・スイッチ
- ガルバニック絶縁IC
- デジタル・パワー
- GaNスマートパワー
- 電源制御IC/ eヒューズ

モータ制御



- ブラシ付きDCモータ・ドライバ
- BLDCモータ・ドライバ
- ステッピング・モータ・ドライバ

アナログ製品



- オペアンプ、コンパレータ、LDOリニアレギュレータ
- 電流センス・アンプ
- EMIフィルタ & シグナル・コンディション
- インタフェース & コネクティビティIC
- リセット & スーパーバイザIC
- 電力線通信IC
- IO-Link
- 耐放射線性デバイス

特定用途向けIC

- 電源制御IC、データ・ストレージおよびサーバ向けプリアンプ
- パーソナル電子機向けワイヤレス充電、タッチ・コントローラ、ディスプレイ用電源制御IC
- 医療用IC

MEMS & 光学センシング・ソリューション



モーション・センサ

- 加速度センサ、ジャイロセンサ
- 慣性モジュール&スマートセンサ
- 振動計、傾斜計
- 地磁気センサ
- T-Plus: 温度センサ内蔵MEMSモーション・センサ



環境＆バイオセンサ

- バイオ・センサ(モーション+生体信号)
- 気圧センサ、圧力センサ
- 温度センサ
- 静電センサ
- MEMSマイクロフォン



アクチュエータ

- プリントヘッド用アクチュエータ
- 圧電アクチュエータ
- 静電アクチュエータ
- 電磁アクチュエータ
- サーマル・アクチュエータ

イメージセンサ

- FlightSense* ToF測距センサ / マルチゾーン対応センサ・モジュール
- 3D FlightSense* ToF測距センサ
- BrightSense*グローバル・シャッター機能搭載イメージ・センサ
- 環境光センサ
- マイクロオプティクス(微小光学)
- カスタムソリューション



汎用MCU & MPU、セキュア・ソリューション & NFC



汎用32bitマイコン & マイクロプロセッサ



- 汎用32bit MCU & 32 / 64bit MPU
「STM32*ファミリー」
- Arm® Cortex®コア搭載
- 高性能 / メイン・ストリーム / 超低消費電力
マイコン・ラインアップ
- グラフィック & AIアクセラレータ
- エッジAI向けの充実したエコシステム

ワイヤレスSoC



- Bluetooth® Low Energy
- Zigbee / Thread / Matter
- Wi-Fiモジュール
- Sub-GHz無線トランシーバ搭載製品 /
Sigfox対応製品
- LoRaWAN®
- RF用拡張エコシステム

セキュア・ソリューション



- モバイル・トランザクション
- 資産識別 & ブランド保護
- 決済システム
- 車載用コネクテッド・サービス

NFC & メモリ



- NFC / RFIDタグIC
- NFCダイナミック・タグIC
- NFC / RFIDリーダライタIC
- 高性能かつ堅牢なEEPROM

STの独自技術に基づく特定用途向けIC



3つの強みを活用した独自技術に基づく特定用途向けIC(ASIC)

- ・先進的な製造技術プラットフォーム
- ・世界各国域に展開する設計リソースおよび先進的な知的財産(IP)
- ・垂直統合型半導体メーカーおよびサプライチェーン

デジタルASIC

CMOSおよびFD-SOIプロセスを用いたSoC
組込み型不揮発性メモリ(eNVM)および
FinFETプロセス・オプション

アナログ & RF ASIC

RFSOI、BiCMOS、ミリ波などの先進技術を
使用した無線(GHz帯)およびアナログ設計
における独自の専門性

MEMS & イメージングASIC

独自のマイクロマシニング・プロセス、
MEMS技術における高い専門性
カスタム・イメージング・ソリューションおよび
プレミアム・ファンドリ

パワーASIC

BCD、ViPower*、SiC、GaN、パワーMOSFET
などを含む幅広い製品ポートフォリオ

製造 & 研究開発



自社工場による高品質 & 柔軟な製造体制



スウェーデン
Norrköping
(ノルショーピン)

フランス
Crolles(クロル)
Rousset(ルッセ)
Tours(ツール)
Rennes(レンヌ)

イタリア
Agrate(アグラテ)
Catania(カターニヤ)
Marcianise
(マルチャニーゼ)



中国
Shenzhen(深セン)

フィリピン
Calamba(カランバ)



- 前工程(ウェハ製造)
- 後工程(組立て & テスト)

マレーシア
Muar(ムーア)

シンガポール

イノベーションを加速させるテクノロジー

製造部門や顧客、パートナーと密接に連携する
世界各地の先端研究開発センター



研究開発スタッフ 約9,300名 (R&Dおよび製品設計)

取得済み / 申請中特許 約21,000件

研究開発費 売上比 約16% (2024年)

研究開発パートナーシップ 約200件

オープン・イノベーションを加速させる13のファブラボ

約80社のスタートアップがSTのプログラムに参加

世界的なトップ・イノベーターとしての評価



顧客 & セールス・オフィス

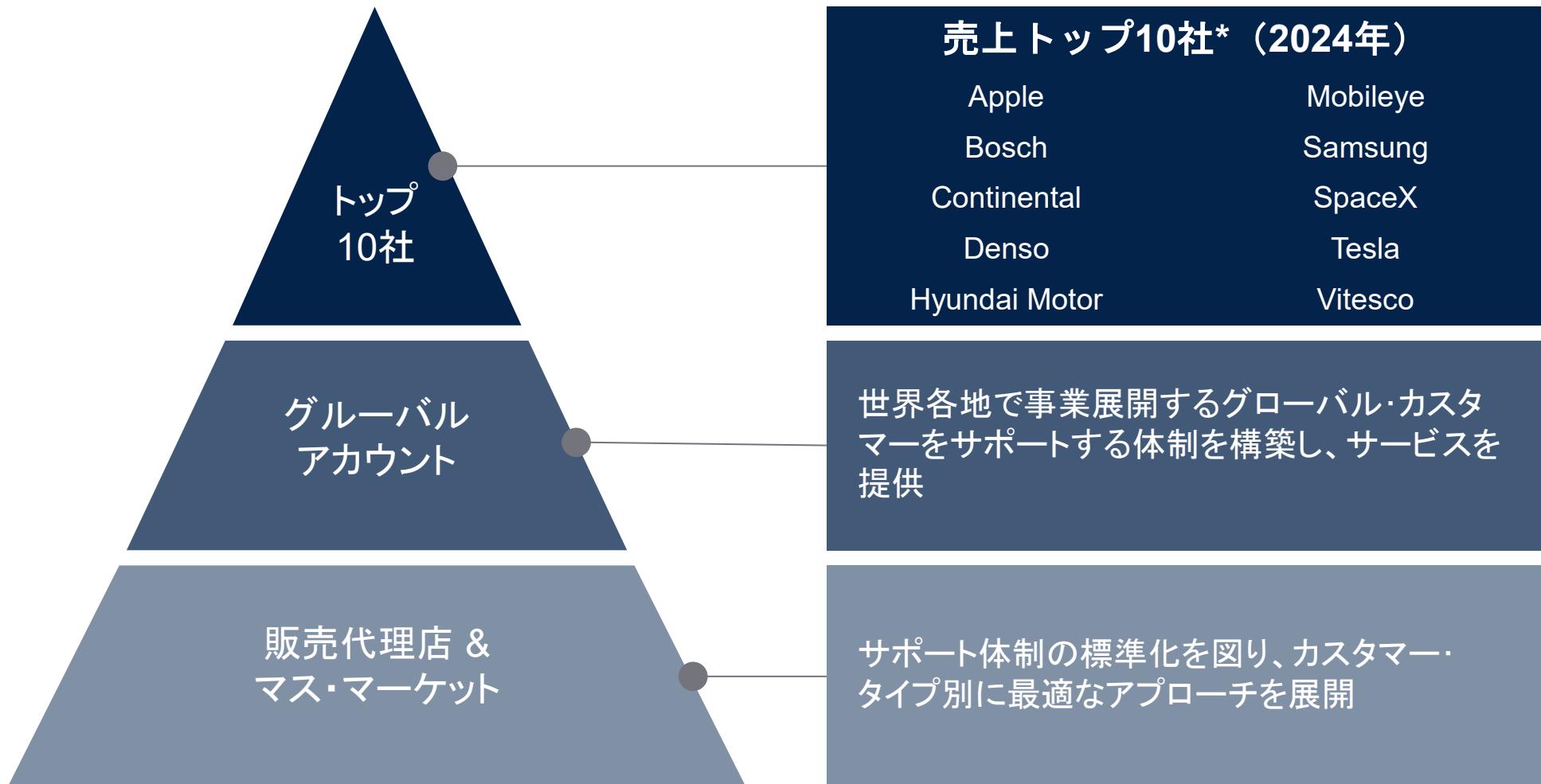


世界に広がる顧客基盤

世界35ヶ国に80以上のセールス・オフィス



20万社以上のお客様をサポート



2025年第3四半期 売上実績

報告セグメント別 売上比率(%)

RF製品 & 光通信
(RF&OC)

-3.4% Y/Y
+2.4% Q/Q

その他

0.1%

11%

31%

アナログ・MEMS
& センサ
(AM&S)

+7.0% Y/Y
+26.6% Q/Q

45%

組込み
プロセッシング
(EMP)

+8.7% Y/Y
+15.3% Q/Q

パワー &
ディスクリート製品
(P&D)

-34.3% Y/Y
-4.3% Q/Q



■ アナログ・パワー & ディスクリート・MEMS・センサ製品グループ(APMS)
■ マイクロコントローラ・デジタルIC・RF製品グループ(MDRF)

エンド・マーケット別 売上比率(%)

通信・コンピュータ
周辺機器

+7% Y/Y
+4% Q/Q

13%

パーソナル
電子機器

+11% Y/Y
+40% Q/Q

27%

39%

オート
モーティブ
-17% Y/Y
+10% Q/Q

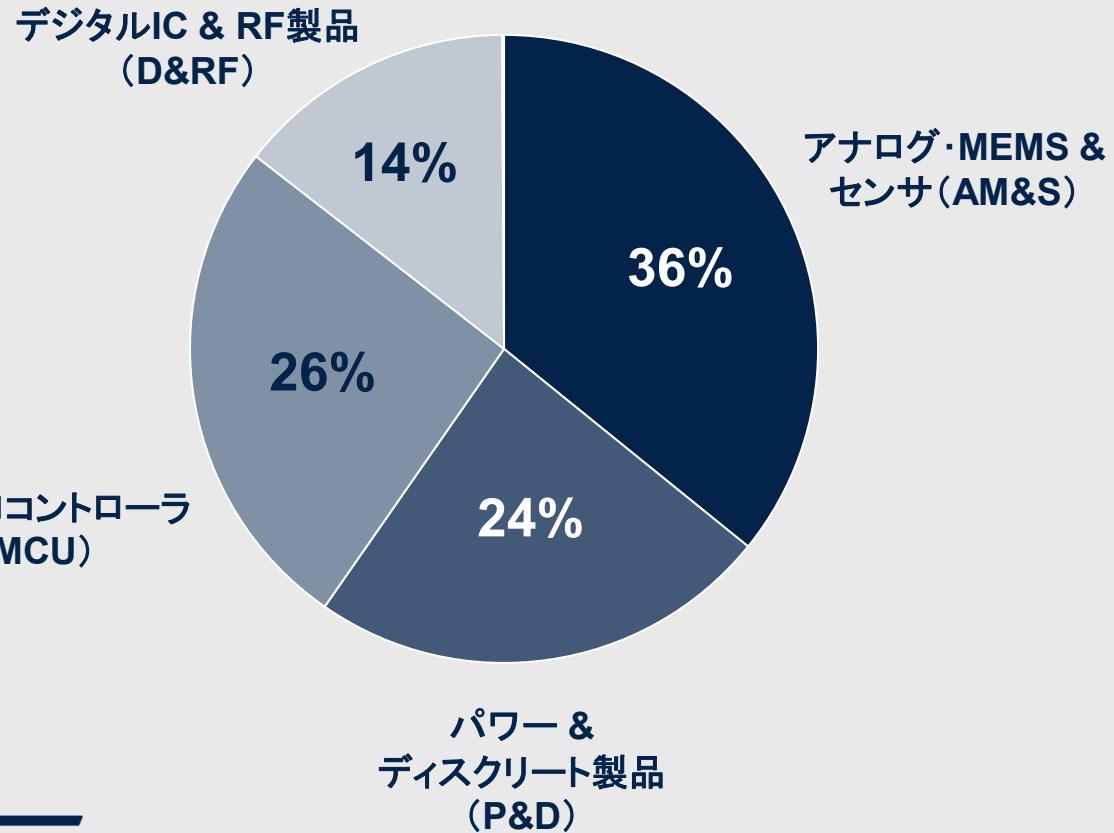
21%

インダストリアル

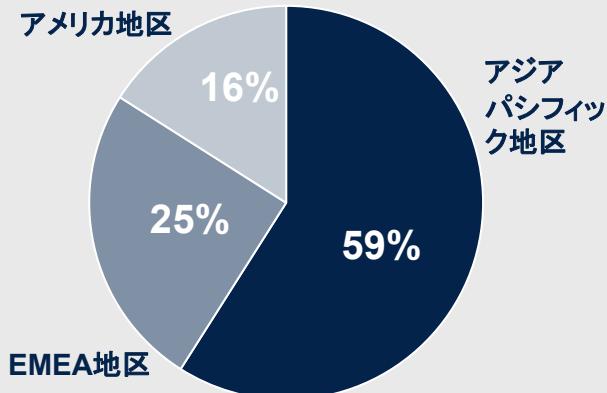
+13% Y/Y
+8% Q/Q

2024年 売上実績

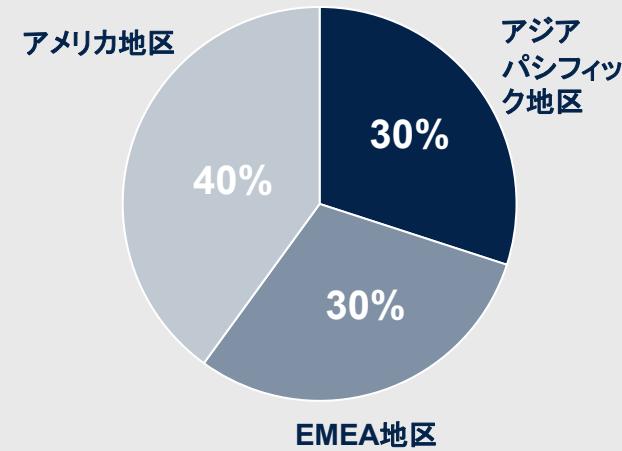
製品グループ別 売上比率(%)



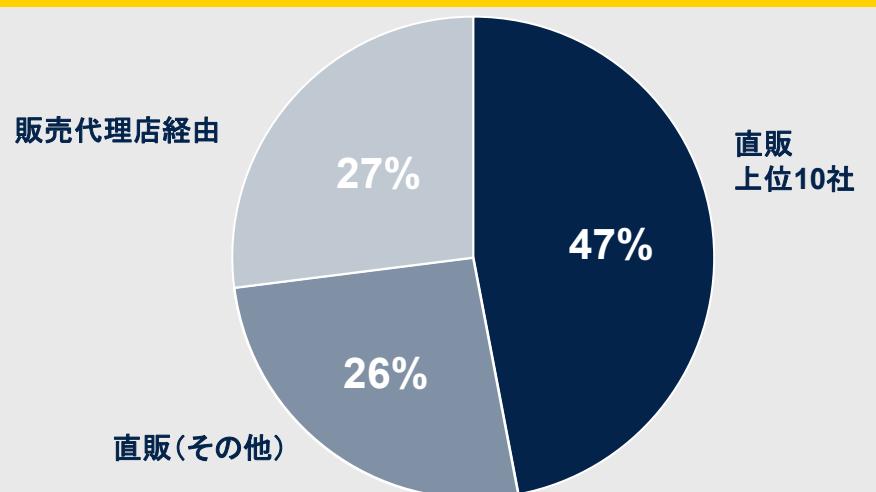
出荷地域別 売上比率(%)



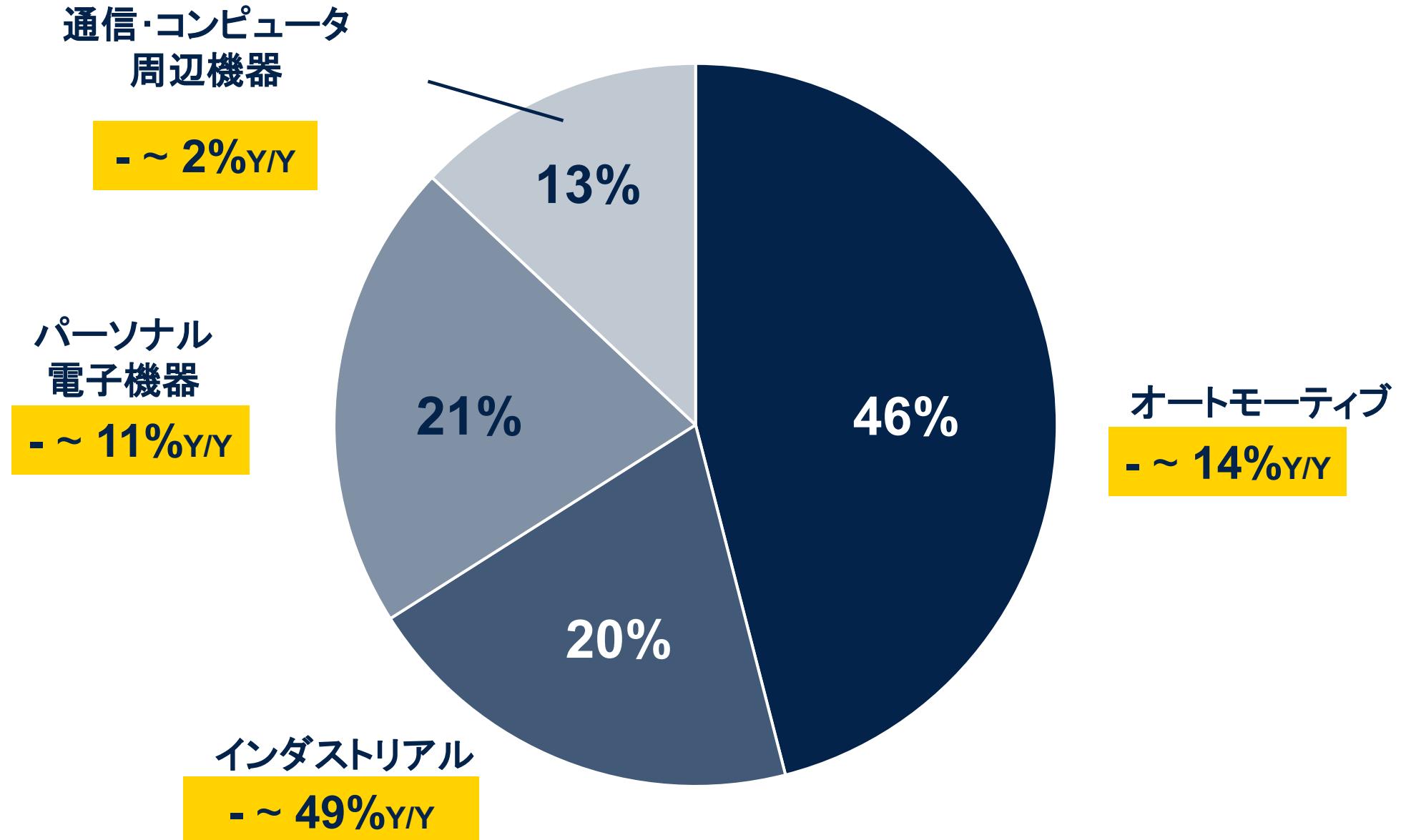
販売地域別 売上比率(%)



販売チャネル別 売上比率(%)



2024年度 エンド・マーケット別売上実績

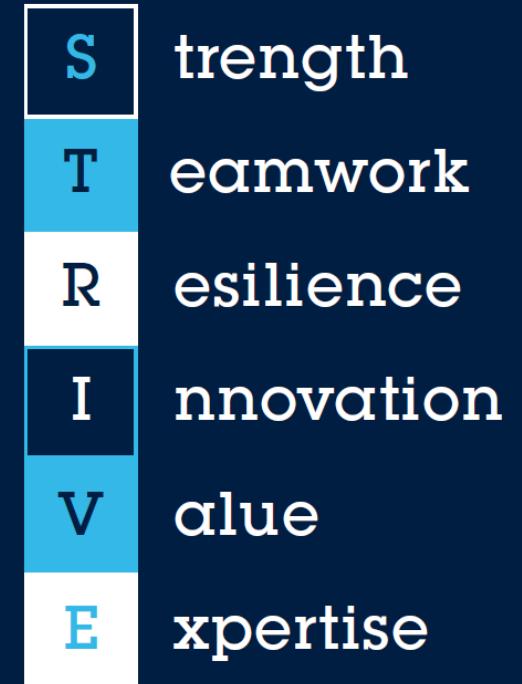


品質への取り組み



企業文化に根付く「品質」

STの品質に対する企业文化は、継続的な品質改善への取り組みや予防思考、「STRIVE for Excellence」の価値観によって推進されています



詳細ウェブサイト: www.st.com/quality

STのビジネスを加速させる品質

STの品質ビジョン

顧客アセットとなる
最高水準の品質の追求

STの品質ミッション

最高水準の品質と信頼性を
合わせ持つ製品の提供

STの品質戦略

- ・ 品質に対するマインドセット、企業文化の導入
- ・ お客様にフォーカスした品質目標の設定
- ・ 高度な品質 / 信頼性に向けたイノベーション
- ・ 結果に基づく効果的な品質向上プログラム



Quality Review



2022 -
2023

★ STRIVE
FOR EXCELLENCE



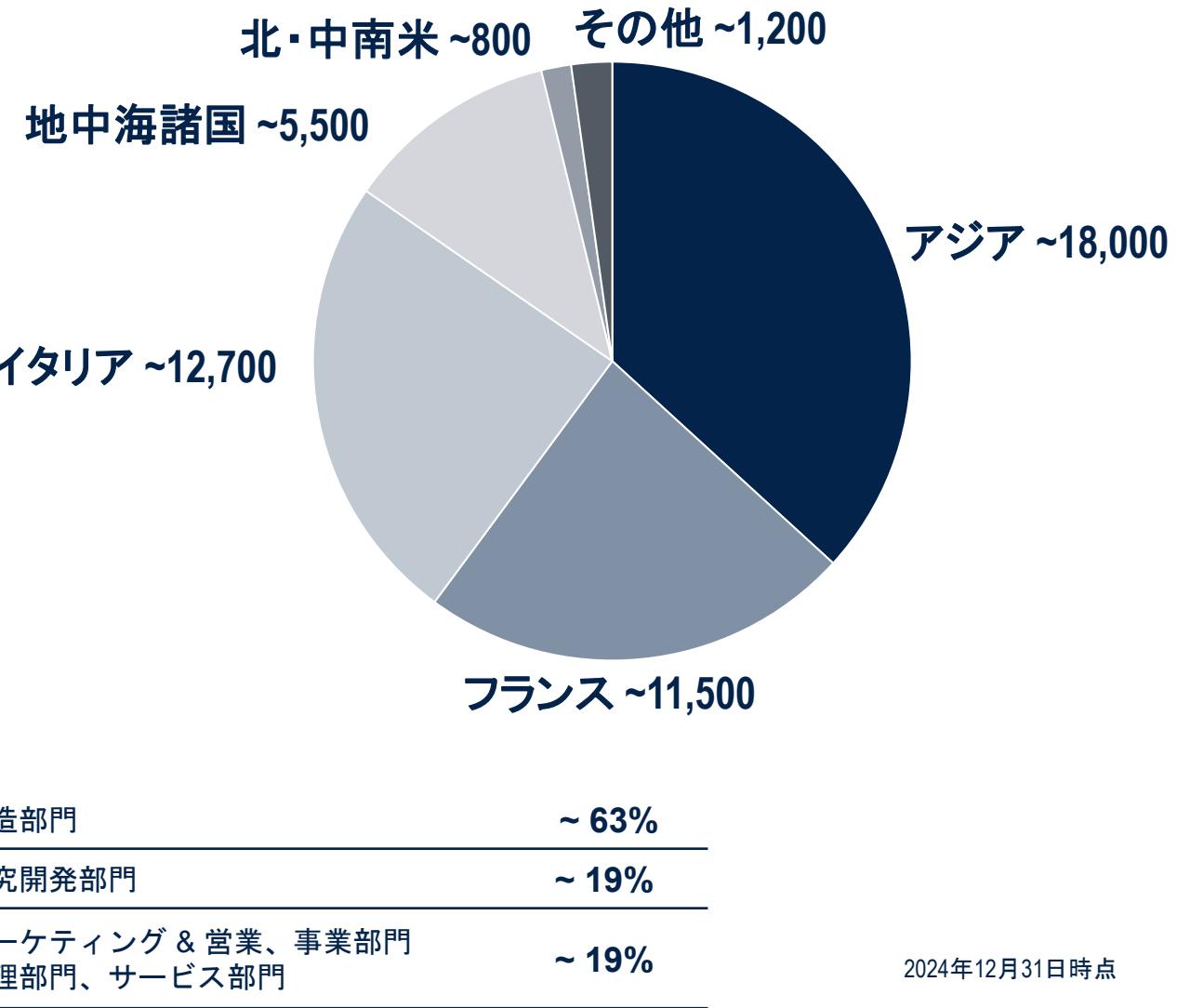
STの品質に関する組織、インフラ、
イニシアティブの年次ステータスや、卓越性
の追求に向けた継続的な取り組みを紹介

[2022年-23年の品質レビューはこちら](#)

従業員



従業員構成



「Global Top Employer 2025」に選出

- STが「Top Employer Global」認定を初めて獲得
- 2025年にこの国際認定を取得した企業は世界で17社
- STは41カ国でTop Employerとして認定



サステナビリティ



30年以上にわたるサステナビリティへの取り組み



The Digital Unify Program (DUP) is the umbrella term under which the Foundation summarizes its core initiatives devoted to fighting the Digital Divide. The goal of the Program is never to stop trying to become more efficient and effective in spreading the benefits of computer knowledge and the lifestyle improvements they can bring along to the disadvantaged beneficiaries. The result leaves the students feeling empowered and knowledgeable about using technology responsibly.



1987	ST設立、ビジネス・コンダクト & エシック・ポリシー
1993	第1回 環境ポリシー
1995	第1回 環境十戒
1997	第1回 環境レポート、ISO 14001、EMAS
2000	国連グローバル・コンパクトの10原則に署名
2001	ST基金設立
2002	森林再生プログラム設置
2003	OHSAS18001安全認証（2021年にISO 45001へ移行）
2007	紛争鉱石プログラム
2011	持続可能なテクノロジープログラム
2012	ISO 50001エネルギー・マネジメント認定
2014	第5回 環境・安全衛生十戒
2016	初のISO 22301 事業継続認定
2020	2027年までのカーボン・ニュートラル達成目標*を設定
2025	報告開始から28年目 STの年次報告書の一部として初の総合報告書を発刊 新しいサステナビリティ・チャーターを発刊

*スコープ1、2に加え、スコープ3では製品輸送、従業員の出張・通勤による排出量の削減に焦点を当てています。44



サステナビリティへの取り組み

持続可能な技術



持続可能な世界に貢献する 技術の創出

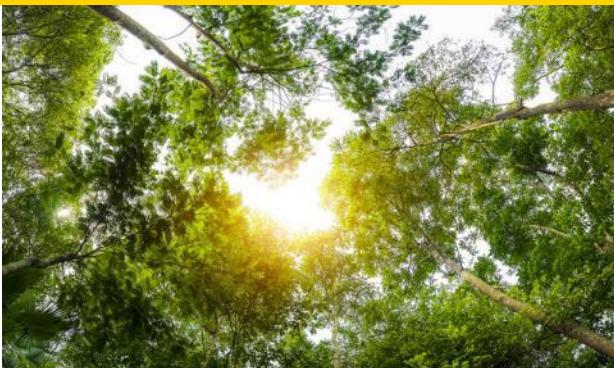
責任ある製品や技術の設計
持続可能な方法による
製品ライフサイクルの管理
責任ある鉱物調達
高効率・低炭素のエコデザイン製品

持続可能な方法



人々を第一に

安全衛生やウェルビーイングの
実現
労働基本権および基本的人権の尊重
多様性 & 包摂性に重視した職場環境
従業員体験の向上



環境を尊重

カーボン・ニュートラル*への
コミットメント
先進的な環境管理システム
水消費量削減 & 水不足リスクへの対応
廃棄物削減 & 循環型経済の促進

持続可能な企業



すべてのステークホルダーへの 長期的価値の創出

リスク・マネージメントの導入
拡張型サプライ・チェーンの
開発 & モニタリング
あらゆるエコシステムにおけるSTEM教育
の推進
成果や進捗に対するモニタリングと透明性
のある報告

STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)



*スコープ1、2に加え、スコープ3では製品輸送、従業員の出張・通勤による排出量の削減に焦点を当てています。 45

STのビジネス・モデル 事業活動による影響の管理

サプライヤ

STは、サプライヤに「RBA(責任あるビジネスアライアンス)行動規範」の実施を要求し、倫理、社会、環境、健康、安全リスクに対処するためのISOおよびOHSAS認証の取得を奨励しています。

また、STは「責任ある鉱物イニシアチブ(RMI)」に加盟しています

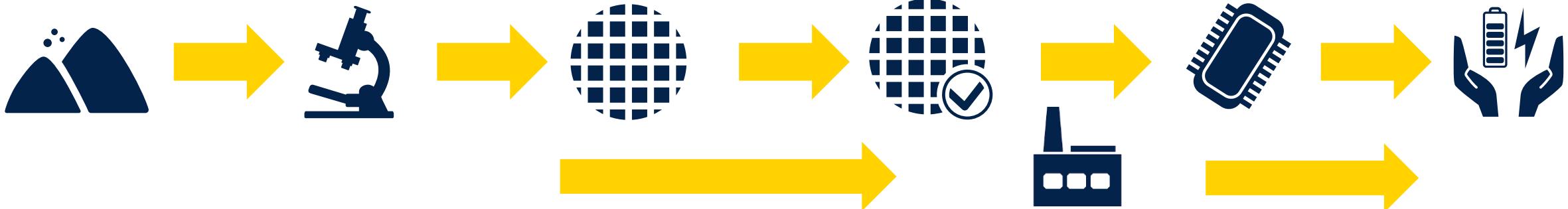
環境

STでは、大気寿命が長く地球温暖化に大きな影響を与えるパーカルオロ化合物(PFC類)をはじめ、あらゆる事業活動から直接的 / 間接的に排出される温室効果ガスを削減するためのプログラムを開発しています。

STは、環境・健康・安全へのリスクを最小化させる予防原則に基づき、製造プロセスで使用される化学物質や材料の選定、取り扱い、および代替を行っています。

STは、再利用およびリサイクルを通じて取水量の削減に継続して取り組んでいます。廃水はすべて、排出される前に処理されています。

STは、廃棄物を可能な限り削減、再利用、リサイクルし、焼却や埋め立てによる処理の削減に努めています。



従業員

STは、高度な管理体制と認可により、従業員の健康および安全を保証しています。

また、倫理・労働・人権リスクを軽減するために、全拠点で独自の行動規範やRBA行動規範を導入し、全生産拠点で定期的な評価・監査を実施しています。

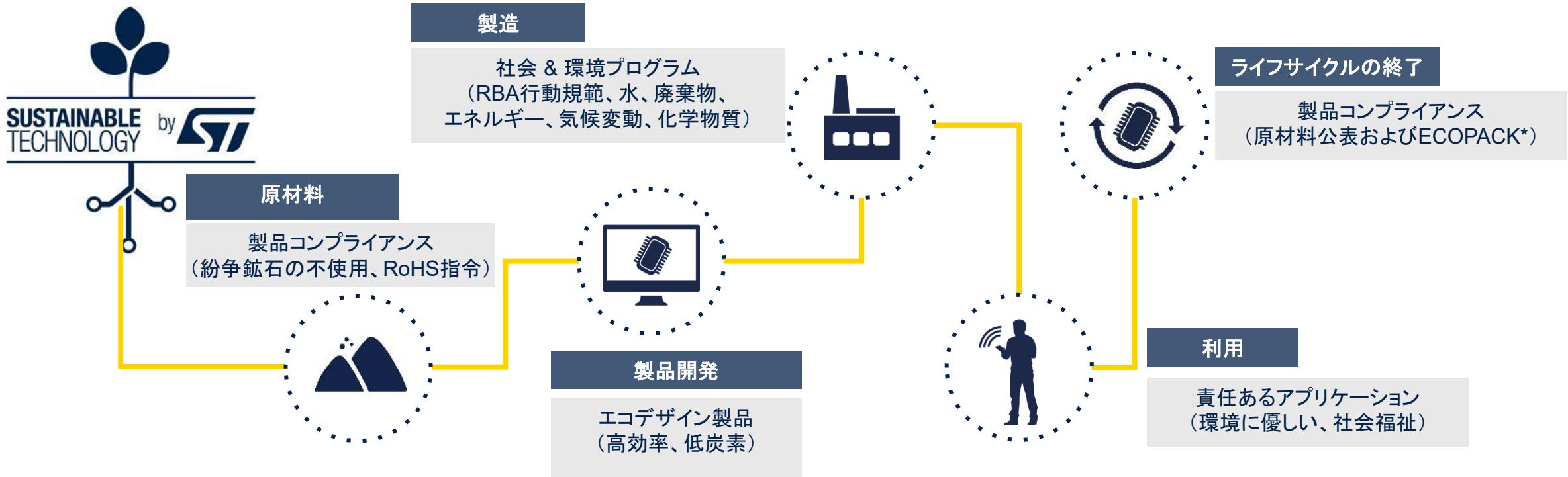
製品

STは、持続可能な技術プログラムを通じて、原材料、輸送、製造、使用、廃棄など製品ライフサイクル全体にわたり環境負荷を考慮した製品を設計しています。

持続可能なテクノロジー

STは持続可能な技術プログラムを通じて、「責任ある製品」を開発

- ・ 製品ライフの各段階における社会・環境資源の消費の改善
- ・ 最終製品における環境や消費者への好影響を最大化



* STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび/またはその他の地域における関連会社の登録商標および/または未登録商標です。

創立40周年までにカーボン・ニュートラルを実現

目標

2025年までに「パリ協定1.5°C目標」に準拠
(SBTi承認済み)

2027年までにカーボン・ニュートラルを実現

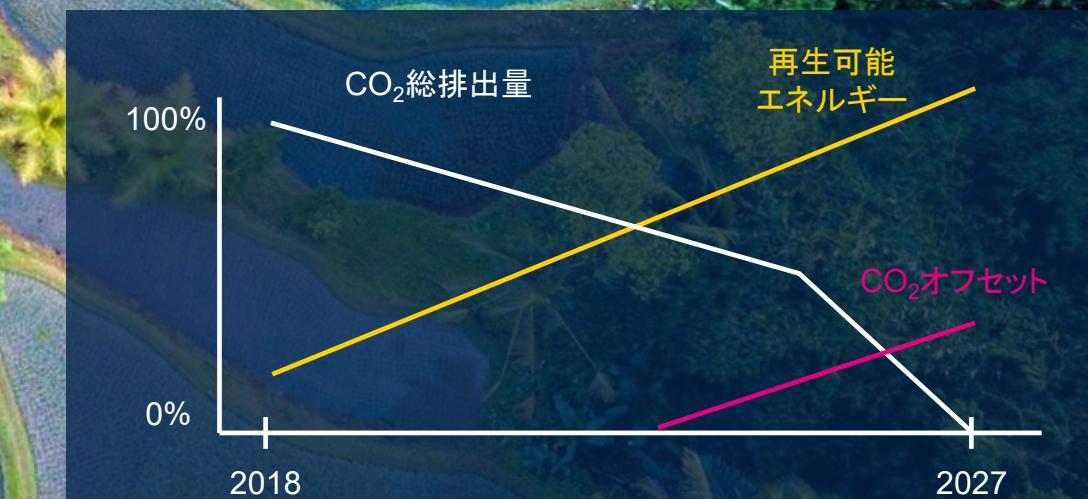
(スコープ1およびスコープ2に関する取り組みに加え、スコープ3では製品輸送、出張、および従業員の通勤による排出に焦点を当てています。)

2027年までに再生可能エネルギーの使用率100%を実現

あらゆるエコシステムに共同プログラムやパートナーシップを導入し、カーボン・ニュートラルを促進

2024年

再生可能エネルギー由来の電力使用率：84%



サステナビリティに関する評価・表彰

TIME誌「世界で最もサステナブルな企業」に選出

CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)
「リーダーシップ・バンド」



世界で最もサステナブルな企業ランキングで
第25位、エレクトロニクス・ハードウェア・機器部門で第1位を獲得



CDPリーダーシップ評
価において、気候変動
対策でA評価、水資源
管理でA-評価を獲得

ST基金のミッション: 人類の進歩を促進するために、最新の科学技術を活用したプロジェクトを開発、企画、サポート



- デジタル格差の解消に向けた継続的な取り組み
- 2003年に発足したDigital Unifyプログラム(DUP)を、これまでに31カ国120万人が受講

2024年、139,000人以上の研究生がコンピュータ・スキル講座(基礎・応用含む)および子供向けタブレット講座を受講

Our technology starts with You



詳細については、[ウェブサイトをご覧ください](#)

© STMicroelectronics - All rights reserved.

ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries.

For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.

All other product or service names are the property of their respective owners.

